



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202240031 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 30

(21) 申请号 201120385897. 6

(22) 申请日 2011. 09. 24

(73) 专利权人 河南鸿昌电子有限公司

地址 461500 河南省长葛市魏武大道河南鸿
昌电子有限公司

(72) 发明人 陈建民 陈建卫 陈磊

(51) Int. Cl.

B23K 3/04 (2006. 01)

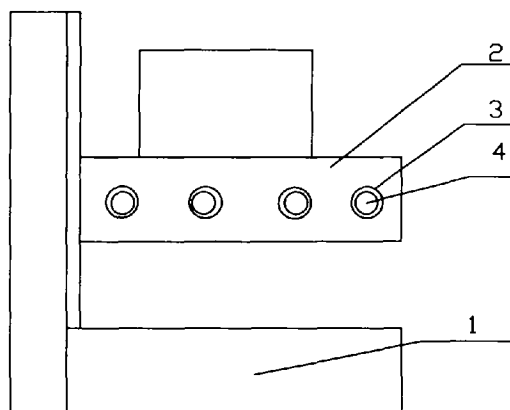
权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

双向加热半导体器件焊接装置

(57) 摘要

本实用新型涉及一种双向加热半导体器件焊接装置,包括底座和底座上活动的压盘,所述的底座具有加热底板,所述的压盘是导热性能好的金属制成的,压盘上具有加热装置,所述加热装置是在压盘内具有安装加热管的空槽,加热管安装在空槽内,这样的双向加热半导体器件焊接装置具有效率高、使用工艺简单、产品质量高的优点。



1. 双向加热半导体器件焊接装置,包括底座和底座上活动的压盘,所述的底座具有加热底板,其特征是:所述的压盘是导热性能好的金属制成的,压盘上具有加热装置。

2. 根据权利要求1所述的双向加热半导体器件焊接装置,其特征是:所述加热装置是在压盘内具有安装加热管的空槽,加热管安装在空槽内。

双向加热半导体器件焊接装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种装置，涉及半导体加工技术领域，涉及半导体器件焊接装置。

背景技术

[0002] 半导体器件是将晶块焊接在瓷板上形成的，焊接装置具有焊接底座，焊接座下部具有加热底板，上部具有压紧的压盘，现有技术中，压盘不具有加热装置，半导体器件往往需要在两面二次焊接，这样的就具有工艺麻烦、效率低、容易出现废品的缺点。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就是针对上述缺点，提供一种效率高、使用工艺简单、产品质量高的双向加热半导体器件焊接装置。

[0004] 本实用新型所采取的技术方案是这样的，双向加热半导体器件焊接装置，包括底座和底座上活动的压盘，所述的底座具有加热底板，其特征是：所述的压盘是导热性能好的金属制成的，压盘上具有加热装置。

[0005] 较佳的技术方案是：所述加热装置是在压盘内具有安装加热管的空槽，加热管安装在空槽内。

[0006] 本实用新型的有益效果是：这样的双向加热半导体器件焊接装置具有效率高、使用工艺简单、产品质量高的优点。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型双向加热半导体器件焊接装置的结构示意图。

[0008] 其中：1、底座 2、压盘 3、空槽 4、加热管。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0010] 如图 1 所示，双向加热半导体器件焊接装置，包括底座 1 和底座 1 上活动的压盘 2，所述的底座 1 具有加热底板，其特征是：所述的压盘 2 是导热性能好的金属制成的，压盘 2 上具有加热装置。

[0011] 较佳的技术方案是：所述加热装置是在压盘内具有安装加热管的空槽 3，加热管 4 安装在空槽 3 内。

[0012] 这样它就能上下双向加热，加工半导体时不易两次加热，简化了工艺。

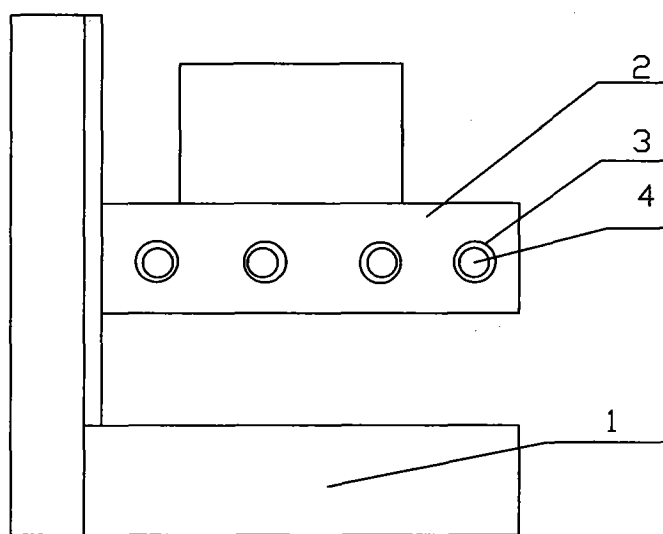


图 1